

上海艾为电子技术股份有限公司

关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 为满足日常生产经营与业务发展需求，上海艾为电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟在《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》（以下简称“本议案”）经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂；

● 被担保人为公司全资子公司，分别为 AWINIC TECHNOLOGY LIMITED、上海艾为半导体技术有限公司、上海艾为微电子技术有限公司、深圳艾为集成电路技术有限公司、上海艾为集成电路技术有限公司、无锡艾为集成电路技术有限公司、苏州艾为集成电路技术有限公司；

● 截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币 21,359.46 万元；

- 本次担保是否有反担保：否；
- 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况；
- 本次申请综合授信额度并提供担保事项尚需经股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足日常生产经营与业务发展需求，公司及子公司拟在本议案经 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 35 亿元（或等值外币）的综合授信额度，并为公司合并报表范围内的子公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的担保额度。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）之间进行调剂。

上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司（包括但不限于）之间分配：

序号	被担保人	担保额度	公司持股比例(%)
1	AWINIC TECHNOLOGY LIMITED	人民币（或等值外币）6 亿元	100
2	上海艾为半导体技术有限公司	人民币（或等值外币）10 亿元	100
3	上海艾为微电子技术有限公司	人民币（或等值外币）3 亿元	100
4	深圳艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100
5	上海艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）8 亿元	100
6	无锡艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100
7	苏州艾为集成电路技术有限公司	人民币（或等值外币）1 亿元	100

上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。

公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司、孙公司）申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、

抵押、质押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东大会审议通过后，股东大会授权董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

二、被担保人基本情况

(一) AWINIC TECHNOLOGY LIMITED

成立日期：2014-07-31

注册地址：4TH FLOOR WORLD TRADE SQUARE, 21 ON LOK MUN STREET, FANLING, HK

董事：孙洪军、郭辉

经营范围：集成电路芯片的销售。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司 100%持股。

主要财务数据：

单位：万元 币种：美金

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	7,854.52
负债总额	8,229.29
资产净额	-374.77
营业收入	33,923.32
净利润	-921.10
扣除非经营损益后的净利润	-928.81

注：以上 2023 年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

(二) 上海艾为半导体技术有限公司

成立日期：2020-08-26

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

法定代表人：孙洪军

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司 100%持股。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	120,350.50
负债总额	24,243.39
资产净额	96,107.11
营业收入	66,445.42
净利润	889.34
扣除非经营损益后的净利润	413.98

注：以上 2023 年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（三）上海艾为微电子科技有限公司

成立日期：2020-09-02

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海洋四路 99 弄 1、5 号 8 层

法定代表人：孙洪军

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路设计；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；通信设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；报关业务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；住房租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司 100%持股。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	53,005.67
负债总额	17,589.18
资产净额	35,416.49
营业收入	7,860.28
净利润	-5,690.66
扣除非经营损益后的净利润	-6,311.56

注：以上 2023 年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（四）深圳艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2021-12-22

注册地址：深圳市南山区西丽街道西丽社区留仙大道创智云城 1 标段 1 栋 D 座 2901

法定代表人：孙洪军

经营范围：一般经营项目是：集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司 100%持股。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	11,412.38
负债总额	6,721.82
资产净额	4,690.56
营业收入	3,177.41
净利润	-330.77
扣除非经营损益后的净利润	-330.83

注：以上 2023 年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（五）上海艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2016-08-31

注册地址：上海市闵行区秀文路 908 弄 2 号 1202 室

法定代表人：孙洪军

经营范围：从事集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、通信器材的销售，从事货物及技术的进出口业务，集成电路设计，办公用品、工艺礼品（象牙及其制品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司 100%持股。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	2,013.00
负债总额	395.49
资产净额	1,617.51
营业收入	1,129.59
净利润	222.11
扣除非经营损益后的净利润	219.99

注：以上 2023 年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（六）无锡艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2018-10-15

注册地址：无锡市新吴区弘毅路 10 号金乾座 1601-1610 室

法定代表人：孙洪军

经营范围：集成电路、电子通信专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信器材的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；集成电路设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司 100%持股。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023年12月31日/2023年度
资产总额	3,732.60
负债总额	709.22

资产净额	3,023.38
营业收入	4,160.99
净利润	1,344.12
扣除非经营损益后的净利润	1,330.14

注：以上 2023 年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

（七）苏州艾为集成电路技术有限公司

成立日期：2019-08-05

注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号 G2-2201 单元

法定代表人：孙洪军

经营范围：集成电路、电子通信技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；电子产品、通信器材的销售；集成电路设计；从事上述货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

子公司类型：全资子公司，股权结构为公司 100% 持股。

主要财务数据：

单位：万元 币种：人民币

类别	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额	1,726.85
负债总额	405.17
资产净额	1,321.68
营业收入	1,934.67
净利润	151.56
扣除非经营损益后的净利润	146.54

注：以上 2023 年度财务数据未经审计

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项，被担保人不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，并结合目前公司业务情况进行的预计，符合公司整体生产经营的实际需要，有助于满足公司日常资金使用及扩大业务范围需求，确保公司经营工作顺利进行，担保风险总体可控。

五、审批程序

公司于 2024 年 4 月 8 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为，公司及子公司向银行等金融机构申请授信，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对被担保对象具有形式上和实质上的

控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及全资子公司不存在为第三方提供担保的事项。截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额人民币 21,359.46 万元，均为公司对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，占上市公司最近一期经审计净资产（归属于母公司所有者权益）和总资产的比例分别是 5.90%和 4.33%。

公司无逾期担保的情况。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 10 日